浙江大学集成电路学院“创芯计划”

开放课题专项申报指南

 浙江大学集成电路学院，以产教融合、科教协同、开放办学为原则，探索面向产业需求的新型教育科研体系和体制创新，学院由集成电路制造技术专家、中国工程院吴汉明院士领衔，坚持开展有组织的科研，具备国内一流的人才队伍，以国家和产业急需解决的重大科研工程问题为导向，科研和教学聚焦于集成电路设计和制造，全面覆盖集成电路产业各项专业。此外，学院还有[浙江省CMOS集成电路成套工艺与设计技术创新中心](http://www.baidu.com/link?url=_ord5r7teUbMac5FfPkj-vFEmrvRQfW0eude0LH6UGCQOFbhkqC1JKPrUgTt299t7ptmjX24Qmr-fAJ3bj69CiFYfu3N9xDp9ZzNXz6wgA_" \t "_blank)（以下简称“创新中心”）支撑，由浙江省、杭州市、萧山区三级政府及浙江大学共同建设。创新中心坚持公共属性和服务功能，以国家重大战略为导向，面向集成电路产业痛点，聚焦CMOS集成电路成套工艺和设计一体化，打破国外关键技术垄断，推动产业高端人才培养，提升产业集群创新能力，实现自主可控和国产替代，在省市区校的全力支持下，创新中心以最低成本、最快速度、最短时间实现12英寸CMOS成套工艺线通线并成功流片，芯片核心器件性能处于国内先进工艺水平。现设立面向集成电路设计和制造技术的“创芯计划”，诚挚邀请国内外相关领域的研究人员申请开放课题资助。

一、开放课题资助方向

2025年，“创芯计划”实验室开放课题基金资助重点支持但不限于以下研究方向：

（一）12吋55纳米芯片制造成套工艺（如CMOS Baseline、嵌入式Flash、BCD等）关键工艺开发，包括光刻、薄膜、刻蚀等工艺模块。

（二）基于55纳米工艺的芯片设计制造一体化技术开发，包括各种IP开发等。

（三）主流集成电路技术相关的前沿和交叉领域，尤其是引领未来产业发展趋势的原创性研究，聚焦硅基新原理/新结构器件、硅基异质集成、先进封装、硅光等迭代技术的研发。

（四）其他有助于创新中心建设的相关技术等。

二、申报条件

（一）资助对象：国内外相关领域具有博士学位或高级职称的研究人员（含博士后），优先资助40岁及以下青年学者。

（二）每项开放课题申请人需与本中心一名固定研究人员进行合作，开展实质性研究工作。中心的固定研究人员同一年度参与申请开放课题合作不超过一项。

（三）申请人在经费申请和经费使用中需符合相关文件的规定。

（四）所申请的开放课题经中心组织专家评审后择优资助；获批后，需按时按质完成课题和提交结题报告。

（五）受“创芯计划”开放课题资助的论文成果，须标注“[浙江省CMOS集成电路成套工艺与设计技术创新中心](http://www.baidu.com/link?url=_ord5r7teUbMac5FfPkj-vFEmrvRQfW0eude0LH6UGCQOFbhkqC1JKPrUgTt299t7ptmjX24Qmr-fAJ3bj69CiFYfu3N9xDp9ZzNXz6wgA_" \t "_blank)”，英文论文应标注“Zhejiang Technology Innovation Center of CMOS IC Manufacturing Process and Design ”。鼓励与浙江大学集成电路学院、以及创新中心固定人员联合发表学术论文。

三、资助额度及年限

每项开放课题资助经费为30万元资助（具体额度根据申报项目的实际需求确定）或者MPW流片（二选一），研究期限为2年。开放课题经费按照相关要求需要在浙大杭州国际科创中心使用，经费不外拨。年度考核优秀者可连续获得第二年资助，具体如下（二选一）：

（一）第1年获得经费支持15万元；如果第1年考核通过，第2年支持15万元。

（二）支持在55nm CMOS平台MPW流片1次；如果第1年考核通过，第2年继续支持1次流片。

四、评审及考核

开放课题设专项评审委员会，由吴汉明院士担任评审委员会主席，成员由本领域专家组成。专项评审委员会负责项目立项评审及年度考核等工作。

（一）评审

符合条件的申请人于12月20日18:00前提交项目计划任务书后，由专项评审委员会进行评审，评审通过者获得资助。

（二）考核

专项评审委员会对资助项目每年进行一次年度考核。具体考核指标由专项评审委员会确定。

浙江大学集成电路学院

 2024年12月4日

备注：有意申请者请填写附件任务书，并于2024年12月20日18：00前发送至邮箱：lvziyi@zju.edu.cn，备注“创芯计划”+姓名。

联系人：吕梓祎，0571-82998681。